



Programm IMAPS-Konferenz, 9.-10. Oktober 2006

Veranstaltungsort: TU München, Theresienstraße, Theresianum, Hörsaal 0602

**Achtung
Terminänderung!!**

Montag, 9. Oktober 2006



**P
L
U
S**

Thema	Vortragender, Firma, Ort der Firma	
09:00	Einschreibung	
10:00	Konferenzöffnung	Jens Müller, IMAPS-Deutschland
10:10	Application of photosensitive materials for microvia substrates	Jan Reboun, TU Pilsen
10:35	Nutzenbasierte "bottom-up"-Plattierung von Durchgangsvias mit hohem Aspektverhältnis für flexible Feinstleitorschaltungen	Stefan Metz, Dyconex, Bassersdorf, CH
11:00	Cu-gefüllte Microvias für kleinere und zuverlässigere Substrate	Daniel Puschmann, GS Präzisions AG, CH
11:25	Inkjet-Druck zum Aufbringen elektrisch leitender Strukturen	Ulrike Currie, HSU Hamburg
11:50	Aussteller stellen sich kurz vor (jeweils 2 min)	
12:20	Mittagspause	
13:20	Herausforderungen an die AVT bei OLED-gerechten Montageprozessen	Marcus Detert, ZµP an TU Dresden
13:45	Thermische und strömungsmechanische Simulation einer Leiterplatte im Reflowofen	Johannes Adam, Flomerics, Filderstadt
14:10	Molybdän-Dünnschichten auf LTCC	Ulrich Schmid, Uni Saarland, Saarbrücken
14:35	Kaffeepause	
15:10	Piezokeramische Dickschichten für Sensoren und Aktoren in der Mikrosystemtechnik	Sylvia Gebhardt, IKTS Dresden
15:35	Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) für die Mikrosystemtechnik aus Sicht des Rahmenprogramms „Mikrosysteme“	Paradiso Coskina, Randolf Schließer, VDI/VDE-IT Berlin
16:00	Herstellung integrierter passiver Komponenten mittels Wafer Level Packaging-Technologien	Kai Zoschke, IZM Berlin
16:25	Ende der Vorträge	
16:30	Mitgliederversammlung	
19:00	Geselliger Abend beim Augustiner	

Dienstag, 10. Oktober 2006



09:00	Technologische Realisierung der Flipchipmontage für 60 GHz Verstärkerschaltkreis auf LTCC	Sven Rentsch, TU Ilmenau
09:25	Successful Implementation of Plasma Treatment for Flip Chip Underfill Applications	John Maguire, March Plasma Systems, GB
09:50	Thermal dissipation enhancement in high reliable underfill systems	Y. Homma, Namics, München
10:15	Elektrochemische Sensoren in Dickschichttechnik	Claudia Feller, IKTS Dresden
10:40	Kaffeepause	
11:40	Schichttechnologien für Fine-Line-Strukturen und Widerstände auf gebrannter LTCC	Günter Reppe, RhE, Radeberg
12:05	Anwendung des Designs of Experiments (DOE) für den Laserabgleich von Widerständen auf LTCC	Rainer Dohle, MSE, Berg
12:30	Pb-freies Pastensystem Dickschicht	John Whitmarsh, ESL, GB
12:55	Neue umweltfreundliche Dickschichtpasten für die Elektronikindustrie	Matthias Metzner, Ferro Hanau
13:20	Schlussworte	Jens Müller, IMAPS-Deutschland
13:25	Ende der Veranstaltung	

Hinweis auf weitere Veranstaltungen

IMAPS-Seminar in Göppingen im Februar 2007

16th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition EMPC 2007 in Oulu, Finnland

EMPS 2006 in Slovenien

Seit 1977 finden unter der Schirmherrschaft von IMAPS (vormals ISHM) alle 2 Jahre (ungerade Jahre) internationale Mikroelektronik- und Packaging-Konferenzen in wechselnden europäischen Ländern statt.

Im Jahre 2000 wurde von der europäischen IMAPS-Dachorganisation ELC (European Liaison Committee) ein weiterer europäischer Konferenzzyklus ins Leben gerufen. Dies sind die in geraden Jahren ausgetragenen *European Microelectronic and Packaging Symposia (EMPS)*, die in etwas kleinerem Rahmen die *European Microelectronic and Packaging Conferences (EMPC)* ergänzen.

Vom 21. - 24. Mai 2006 fand in der Terme Catez, Slovenien, das 4th *European Microelectronic and Packaging Symposium* statt.

Gestartet wurde diese Veranstaltung am Sonntag mit einem *Satellite Workshop on Ferroelectric Thin & Thick-films Processing and Their Applications in MEMS*, auf dem insgesamt 6 Fachbeiträge vorgestellt wurden.

Ebenfalls am Sonntag fand eine Sitzung des ELC (*European Liaison Committee*) statt. Dieses Gremium, in dem Repräsentanten aller europäischen IMAPS-Chapter vertreten sind, tagt 2...3-mal im Jahr, um die Belange von IMAPS Europa zu koordinieren (Abb. 1). Wichtige Punkte der Sitzung waren die fortlaufende Organisation der europäischen Konferenzen (die nächste Konferenz findet 2007 in Oulu, Finnland, statt), der Startschuss für das gemeinsame IMAPS-Europa-Webportal (www.imapseurope.org) sowie die Zusammenarbeit mit den internationalen IMAPS-Chaptern aus Amerika und Asien



Abb. 1: ELC-Meeting

(im *WLC – World Liaison Committee* arbeiten 2 Vertreter des *ELC* mit) und weiteren Organisationen wie z.B. *IEEE CPMT*.

Sowohl der Satellite-Workshop als auch die Arbeitssitzung des *ELC* endete am Sonntagabend mit einer kleinen Welcome-Party, die die Organisatoren des *4th European Microelectronic and Packaging Symposium* „Fusion Party“ getauft hatten. Hier konnten sich in gemütlicher Atmosphäre bei einem kleinen Büffet die bereits eingetragenen Teilnehmer des Symposiums, die Teilnehmer des Satellite-Workshops sowie die Teilnehmer der *ELC*-Sitzung kennenlernen bzw. alte Bekannte wieder einmal treffen.

Zentraler Punkt der Veranstaltung waren aber die insgesamt 12 fachlich gegliederten Sessions mit je 4...5 Fachbeiträgen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen, die von Montag bis Mittwoch stattfanden. Insgesamt wurden 50 zum großen Teil sehr interessante und teilweise auch recht innovative Vorträge präsentiert. Ergänzt wurden diese „normalen“ Sessionbeiträge durch 3 eingeladene Sprecher in der Opening-Session und durch eine Spezial-Session mit dem Thema *European R&D Networks*, in der 4 Beiträge die Zuhörer über die europäische Forschungslandschaft informierten.

Neben der Präsentation von Fachbeiträgen wurde das Symposium vom derzeitigen *ELC*-Präsidenten *Paul Collander* genutzt, den langjährigen *IMAPS (ISHM)*-Aktivisten *Peter Barnwell* zu ehren. Ihm wurde zu Beginn des Symposiums die Ehrenmitgliedschaft im *ELC* überreicht (Abb. 2).

In den Pausen hatten die insgesamt ca. 120 Symposiumsteilnehmer die Gelegenheit, sich bei den Ausstellern über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Weiterhin waren insgesamt 21 Poster im Ausstellbereich aufgestellt. Hier hatten die Teilnehmer eine



Abb. 3: Die gut besuchte Poster-Session

weitere Gelegenheit, ihr Wissen zu erweitern, in dem sie mit den Autoren der Poster diskutierten (Abb. 3).

Neben allen fachlichen Belangen einer solchen Tagung sollen natürlich die sozialen Aspekte nicht zu kurz kommen. Neue und alte Kontakte zu pflegen, dafür gab es genügend Gelegenheiten. Die Organisatoren von *IMAPS Slovenia* hatten sich alle Mühe gegeben, ein wirklich respektables Beiprogramm zu organisieren, das neben der bereits erwähnten Fusion-Party aus einer Welcome-Party, einem Besuch des berühmten Klosters *Kostanjevica* (Abb. 4) und einem Gala-Dinner bestand. Abgerundet wurde dieses Beiprogramm durch einen optionalen Besuch der Firma *HYB o.o.b.*, die die Veranstaltung gesponsert hat und die in ihrer nahe gelegenen Fabrik *Hybride* für unterschiedlichste Anwendungen entwickelt und produziert. Dieser Firmenbesuch am letzten Tag wurde noch von sehr vielen Teilnehmern wahrgenommen.

Insgesamt darf an dieser Stelle folgendes Fazit gezogen werden: Das *4th European Microelectronic and Packaging Symposium*, organisiert durch *IMAPS Slovenia* war fachlich und sozial wieder einmal ein Volltreffer und reiht sich somit gleichermaßen in die Reihe der bereits abgeschlossenen Konferenzen und Symposiumen ein.



Abb. 2: Auszeichnung für *Peter Barnwell* mit der Ehrenmitgliedschaft



Abb. 4: Die Teilnehmer im Kloster *Kostanjevica*

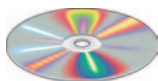
Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Dresden	5.- 7.9.2006	ESTC 2006	TU Dresden
Ilmenau	11.-15.9.2006	Internationales Wissenschaftliches Kolloquium	TU Ilmenau
Göteborg, Schweden	17.-19.9.2006	IMAPS Nordic Conference 2006	IMAPS Nordic
Kraków, Polen	24.-27.9.2006	30 th International IMAPS Poland Conference & Exhibition	IMAPS Poland
Besançon, Frankreich	26.-29.9.2006	Interconex 2006	IMAPS France

Hinweis: Für die *ESTC 2006* erhalten *IMAPS Deutschland*-Mitglieder den gleichen Rabatt wie *IEEE*-Mitglieder. (400,- € statt 500,- € Konferenzbeitrag.)

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

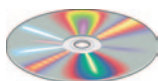
und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2005*, die am 10. und 11. Oktober 2005 in München durchgeführt wurde, sind noch als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Gustav-Kirchhoff-Straße 7

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Egerlandstraße 88

D-73431 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik

Schatzmeister

c/o FH Rosenheim

Hochschulstraße 1

D-83024 Rosenheim

Fon: 08031/805-629

Fax: 08031/805-603

e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer
Schriftführer
c/o FH Schmalkalden
FB Elektrotechnik
D-98574 Schmalkalden
Fon: 03683/688-5116
Fax: 03683/688-5499
e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit
und Mikrointegration
Chip Interconnection Technologies
Gustav-Meyer-Allee 25
D-13355 Berlin
Fon: 030/46403-164
Fax: 030/46403-161
e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VIA electronic GmbH
Robert-Friese Straße 3
D-07629 Hermsdorf
Fon: 036601/81-529
Fax: 036601/81-530
e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina
Öffentlichkeitsarbeit
c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
D-10623 Berlin
Fon: 030/310078-242
Fax: 030/310078-256
e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
PF 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de